

January 16, 1998

TEL:805-498-2111 FAX:805-498-3804 WEB: <http://www.semtech.com>

HIGH CURRENT, HIGH DENSITY, THREE PHASE FULL WAVE BRIDGE RECTIFIER.

QUICK REFERENCE DATA

- Low thermal impedance
- Small size and low weight
- High current applications
- Isolated for direct heatsink mounting
- High surge ratings

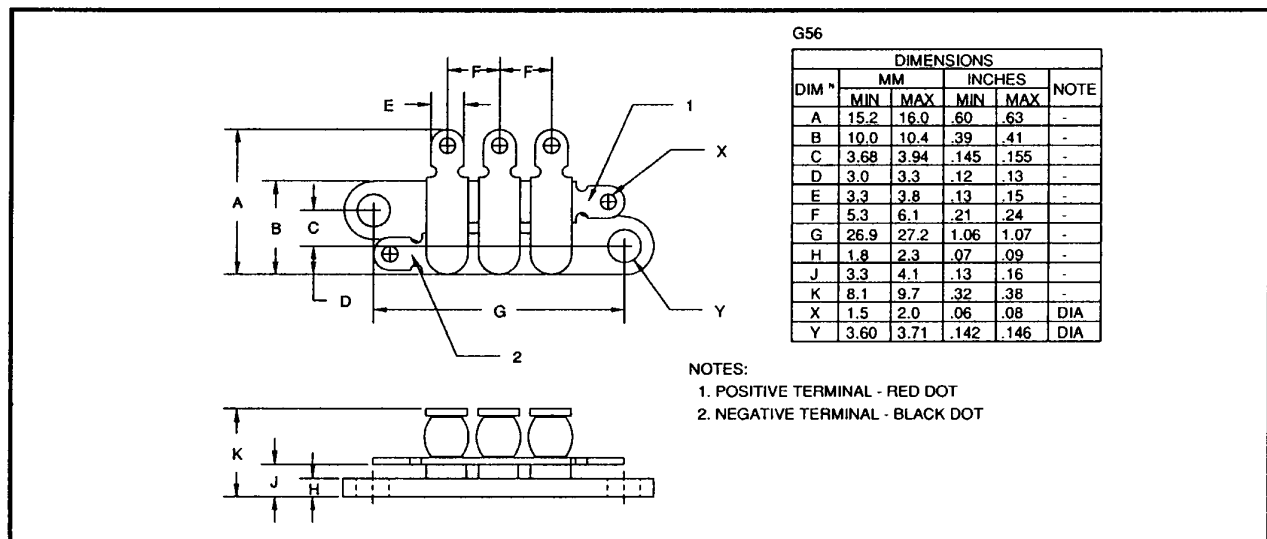
- $V_R = 150V - 1000V$
- $I_O = 45A$
- $t_{rr} = 30nS - 2\mu S$
- $I_{FSM} \geq 150A$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Device Type	Working Reverse Voltage (V_{RWM})	Average Rectified Current ($I_{F(AV)}$) @ T_{mb}			1 Cycle Surge I_{FSM} $t_p = 8.3mS$		Repetitive Surge (I_{FRM})	Operating & Storage Temperature Range	
		@ 55°C	100°C	125°C	@ 25 °C	@ 100°C	@ 25 °C	(T_{OP})	(T_{STC})
		Volts	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	°C
SET111403	1000	45	33	24	150	100	25	-55 to +175	
SET111419	1000	30	24	18	150	80	15	-55 to +175	
SET111412	600	45	33	24	150	100	25	-55 to +175	
SET111404	400	45	33	24	150	80	25	-55 to +175	
SET111411	150	45	30	21	175	175	24	-55 to +150	

$$R_{\theta jc} = 0.5^{\circ}C/W$$

MECHANICAL



January 16, 1998

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Device Type	Maximum Leakage Current I_R @ V_{RWM}		Maximum Forward Voltage V_F @ 9A @ 25°C	Maximum Reverse Recovery Time. ¹ t_{rr}
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = 100^\circ\text{C}$		
	μA	μA	Volts	nS
SET111403	3.0	60	1.2	2000
SET111419	3.0	75	2.2	150
SET111412	3.0	60	1.2	2000
SET111404	3.0	60	1.5	150
SET111411	30.0	1.5mA	1.1	30

¹ Measured on discrete devices prior to assembly

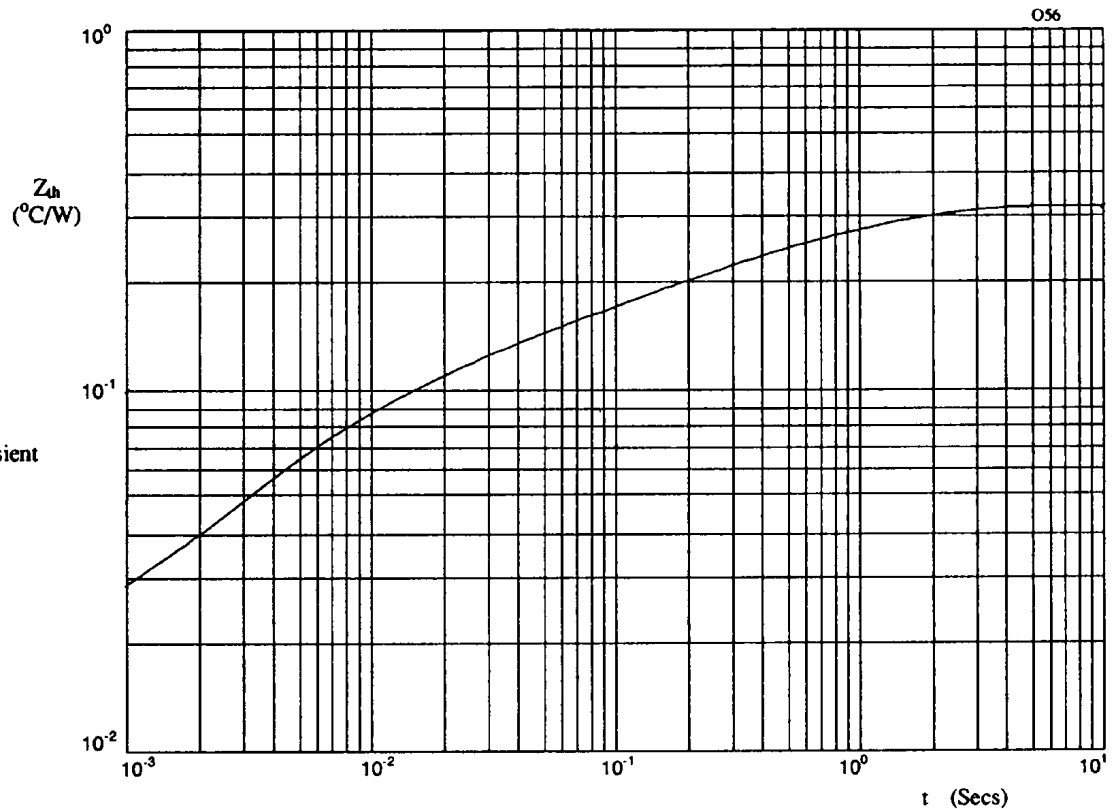


Figure 1. Typical transient thermal impedance characteristic.

January 16, 1998

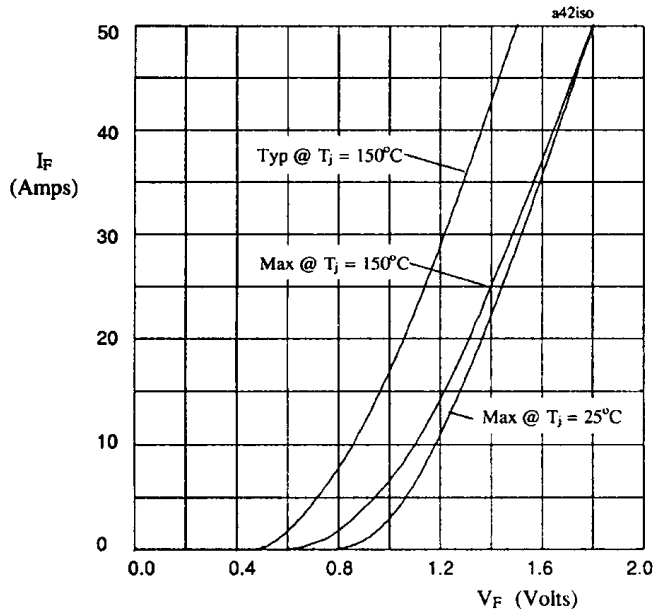


Figure 2. Forward voltage drop per leg as a function of forward current for SET111403 & SET111412.

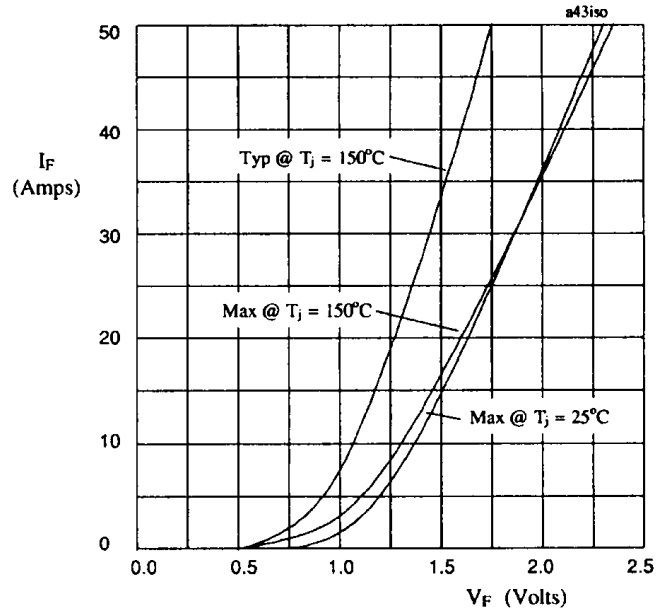


Figure 3. Forward voltage drop per leg as a function of forward current for SET111404.

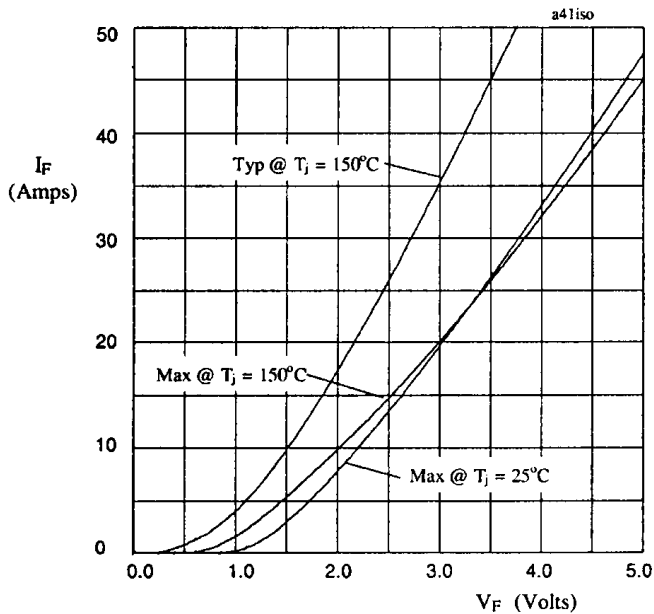


Figure 4. Forward voltage drop per leg as a function of forward current for SET111419.

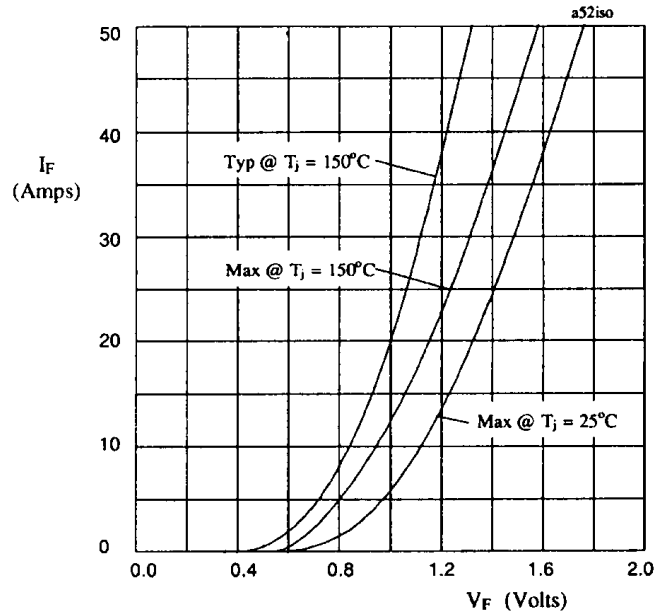


Figure 5. Forward voltage drop per leg as a function of forward current for SET111411.

January 16, 1998

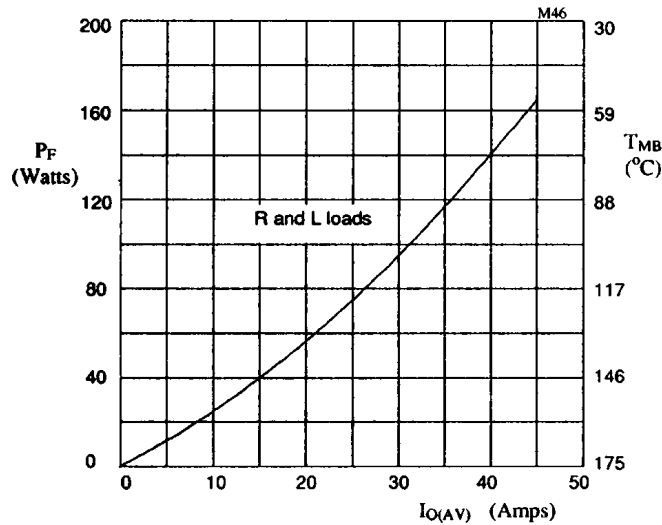


Figure 6. Forward power dissipation and maximum allowable mounting base temperature as a function of output current for sinusoidal operation, for SET111403 and SET111412.

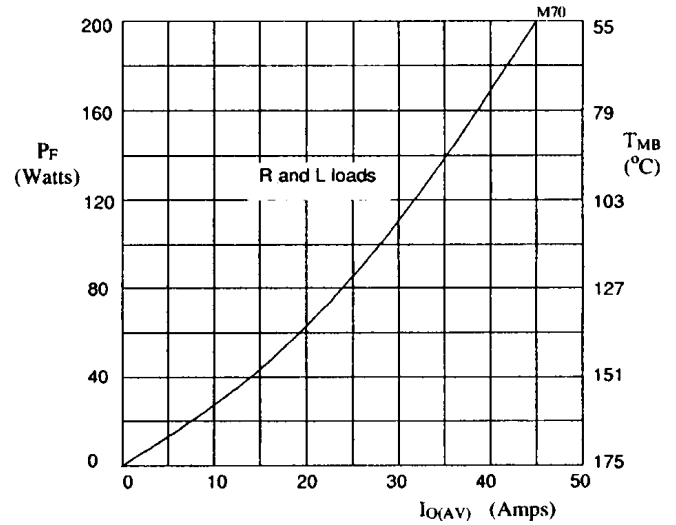


Figure 7. Forward power dissipation and maximum allowable mounting base temperature as a function of output current for sinusoidal operation, for SET111404.

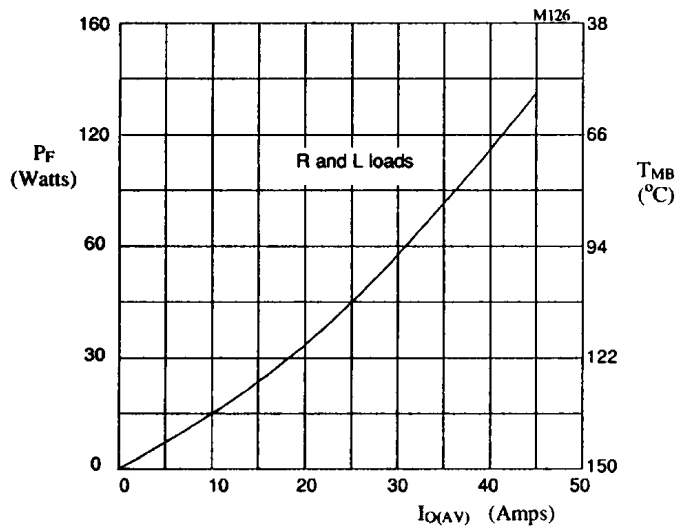


Figure 8. Forward power dissipation and maximum allowable mounting base temperature as a function of output current for sinusoidal operation, for SET111411.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9